

ATM-8100S 全自動ウェーハマウンター (薄厚ウェーハ対応)

Automatic Wafer Mounter (for thin wafer)

【概要 - Outline -】

◆本装置はダイシング前工程として全自動でダイシングフレームへウェーハをマウントする装置です。
The ideal system for mounting wafers to dicing frames, before the dicing process.

【特長 - Features -】

- ◆特殊ハンドリングシステム、真空チャンバー内でのウェーハ反り矯正機構により
Wafer warp is corrected by vacuum holding in vacuum chamber.
8インチ 厚み 150 μ m、反り 5mm までの薄厚反りウェーハに対応。
Applicable 150 μ m thickness, 5mm warped wafer.
- ◆ウェーハを真空中で貼付けるため気泡の混入がなく貼付けが可能です。
Adjustable for use with a wide range of tapes by the Tape tension memory function.
また、低荷重での貼付けが可能となり、ウェーハにダメージを与えません。
- ◆テープテンションメモリー機能を持ち、どのような ロールタイプの
Carrier station memory function
ダイシングテープにも対応が出来ます。
- ◆IDリーダー、バーコードシステムの装置内臓
Option: ID reader, Barcode labeller
(オプション)



仕様 Specification	ATM-8100S	
スループット Throughput	80 枚 /h (ご使用条件により異なります Depend on data setting)	
対応ウェーハサイズ Wafer Size	4・5・6・8 inch	
フレームサイズ Frame Size	2-6-1 / 2-8-1	
使用テープ幅 Tape Width	6 inch : W 230 mm / 8 inch : W 300 mm	
ユーティリティ Utilities	電源 Power	AC200V 単相 Single phase 50/60Hz 3.0KVA
	空気源 air	圧力 Pressure 0.5Mpa 300NI/min
装置寸法 Demension	W 1,830 × D 1,300 × H 1,800 mm	
重量 Weight	850 kg	

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.